最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第564號

上　訴　人　中華精測科技股份有限公司
代　表　人　黃秀谷
訴訟代理人　張耀暉　專利師
上　訴　人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
被上訴人　廣流智權有限公司
代　表　人　李文賢

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國107年10月25日智慧財產法院107年度行專訴字第61號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、本件上訴人中華精測科技股份有限公司（下稱中華精測公司）係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）一致，依本院民國97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議意旨，本件應併列智慧局為上訴人。

二、緣上訴人中華精測公司於101年11月23日以「探針卡免焊接結構」向上訴人智慧局申請新型專利（申請專利範圍共7項，第1、2項為獨立項，其餘為附屬項），經上訴人智慧局編為第000000000號審查後，於102年4月8日核准專利，並於102年7月11日公告發給第M457182號專利證書（下稱系爭專利）。嗣被上訴人於106年5月2日以系爭專利違反100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）第120條準用第22條第2項規定，而對之提起舉發，經上訴人智慧局審查，於106年10月17日以(106)智專三(二)04183字第10621045780號專利舉發審定書為「請求項1至7舉發不

成立」之處分（下稱原處分）。被上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，被上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，聲明：訴願決定及原處分均撤銷，上訴人智慧局應就系爭專利舉發事件作成「請求項1至7舉發成立，應予撤銷」之處分。經原審依職權命上訴人中華精測公司獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟，判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人智慧局應就系爭專利舉發事件作成「請求項1至7舉發成立，應予撤銷」之處分，上訴人中華精測公司不服，提起本件上訴。

三、被上訴人起訴主張及上訴人中華精測公司、智慧局原審答辯，均引用原判決所載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。本件被上訴人就系爭專利不具進步性之同一撤銷理由，於起訴時提出證據5、6、7之新證據，法院自應併予審理。

系爭專利說明書自承之先前技術已揭露一種探針卡結構，其與系爭專利請求項1之差異在於系爭專利之先前技術未揭示轉接介面板第一面覆蓋有一層防焊層，且係利用垂直導電膠作為探針卡母板於轉接介面板之連接，而系爭專利請求項1係於「轉接介面板第一面覆蓋有一層防焊漆，且該導電彈性凸塊仍突出於該層防焊漆；其中，當探針卡母板與轉接介面板相互結合時，每一個探針卡母板金屬墊與該每一個導電彈性凸塊進行電性連接。」證據5係揭示一種IC測試載板免焊接組裝結構，證據5圖7顯示於IC測試載板及IC測試母板上均覆蓋有一防焊綠漆25，且金屬凸塊26突出於防焊綠漆25，故證據5已揭示系爭專利請求項1之防焊層及利用金屬凸塊作為IC測試母板與IC測試載板之接合，以取代習知以焊接之接合方式。系爭專利自承之先前技術與證據5皆為一種運用於IC測試之探針卡，兩者技術領域相同，所欲解決問題具共通性

，且先前技術中之錫球焊接、彈簧針連接器及垂直導電膠與證據5之凸塊均係作為不同板塊間之電性及信號連接，功能及作用上亦具共通性，故所屬技術領域中具通常知識者可依據系爭專利之先前技術結合證據5之金屬凸塊，並將該金屬凸塊採用彈性材質以達成緩衝效果，進而完成系爭專利請求項1之創作，並未產生無法預期之功效，故由系爭專利之先前技術及證據5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

系爭專利之先前技術及證據5、6之組合足以證明系爭專利請求項1、2、3不具進步性： 證據6揭示一種應用於探針卡的中介基板，與證據5及系爭專利自承先前技術為相同或相關之技術領域，因證據5及系爭專利自承先前技術之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性，故證據5、證據6及系爭專利自承先前技術之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性。 系爭專利請求項2為一種探針卡免焊接結構，其與請求項1之差異在於請求項2不包含防焊漆，且請求項2界定每一個轉接介面板金屬墊被一導電彈性凸塊所覆蓋。證據5雖未明確揭示「每一個轉接介面板金屬墊被一導電彈性凸塊所覆蓋」該技術特徵，惟將凸塊形成金屬墊上並覆蓋該金屬墊，為一般印刷電路板或晶圓製程所使用之習知技術或慣用手段，或可由系爭專利自承先前技術及證據5之組合完成。另查證據6揭示一種具有金屬凸塊的中介基板，分別連接至一印刷電路板與一受測晶圓，其中第3A圖及第4C圖已揭示於中介基板上形成一金屬墊103b，再於金屬墊上形成一凸塊310c而覆蓋金屬墊，故證據6亦已揭示系爭專利請求項2之附屬技術特徵，因證據6、證據5及系爭專利自承先前技術均為IC測試板之相同或相關之技術領域，且證據5及證據6之凸塊均在作為板材間之電性連接用，兩者之凸塊於作用及功能具有共通性，故證據5、證據6及系爭專利自承先前技術之組合亦可證明系爭專利請求項2不具進步性。3.系爭專利請求項3為導電彈性凸塊之材料之限定，對於系爭專利之新型專利而言，為

非結構特徵，該非結構特徵並不會改變或影響結構特徵，則該非結構特徵將視為習知技術之運用，因證據5及系爭專利自承先前技術之組合即足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，故證據5、證據6及系爭專利自承先前技術之組合可證明系爭專利請求項3不具進步性。

ŋ 證據2、5、6及系爭專利自承之先前技術之組合足以證明系爭專利請求項4至6不具進步性： 系爭專利請求項4係依附於請求項1或2，進一步包含「至少一緩衝墊板；至少一治具座；及至少一金屬壓板，係位於與該轉接介面板第一面相對之一轉接介面板第二面；其中，當該探針卡母板與該轉接介面板相互結合時，該緩衝墊板係位於轉接介面板之周圍，該治具座係位於緩衝墊板之周圍，該金屬壓板則以一個垂直於該轉接介面板第二面且平行於緩衝墊板之周圍與治具座之周圍的方向，壓制於緩衝墊板、治具座與轉接介面板第二面上」，證據2圖1揭示當探針卡母板（PCB母板）與轉接介面板（積體電路測試載板）2相互結合時，治具座（治具框座）4係位於轉接介面板（積體電路測試載板）2之周圍，治具座（治具框座）4位於緩衝墊板（墊板）5之周圍，金屬壓板（上壓制板）1則以一個垂直轉接介面板（積體電路測試板）2之第二面平行於緩衝墊板（墊板）5之周圍與治具座4之周圍方向，壓制於緩衝墊板（墊板）5、治具座（治具框座）4與轉接介面板（積體電路測試載板）2之第二面上，故證據2已揭示系爭專利請求項4之附屬技術特徵。又證據2與系爭專利先前技術及證據5均為探針卡結構之相同技術領域，且三者均在解決探針卡中不同板材間之連接之技術，解決問題具關聯性，故系爭專利先前技術、證據2及證據5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性，證據2、證據5、證據6及系爭專利自承先前技術之組合亦可證明系爭專利請求項4不具進步性。 系爭專利請求項5係依附於請求項4之附屬項，其進一步界定「其中，當該金屬壓板壓制於緩衝墊板、治具座與轉接介面板第二面上時，金屬壓板中間有一開槽處，為一頂

針區」證據2第1圖揭示之上壓制板1相當於系爭專利之金屬壓板，當金屬壓板（上壓制板）1壓制於緩衝墊板（墊板）5、治具座（治具框座）4與轉接介面板（積體電路測試載板）2第二面上時，二片上壓制板1間的間隙揭示「頂針區」，故證據2亦揭示系爭專利請求項5之附屬技術特徵，則證據2、證據5及系爭專利自承先前技術之組合即足以證明系爭專利請求項5不具進步性，證據2、證據5、證據6及系爭專利自承先前技術之組合亦可證明系爭專利請求項5不具進步性。

系爭專利請求項6係依附於請求項1或請求項2之附屬項，其進一步界定「其中，該導電彈性凸塊之摻雜的金屬粉粒係下列任一種或其組合：鋁、銅、銀與金」惟導電彈性凸塊材料之限定，對於系爭專利之新型專利而言，為一非結構特徵，該非結構特徵並不會改變或影響結構特徵，則該非結構特徵將視為習知技術之運用，因證據5、6及系爭專利自承先前技術之組合即足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，故證據2、5、6及系爭專利自承先前技術之組合亦可證明系爭專利請求項6不具進步性。

ē 系爭專利請求項7係依附於請求項4之附屬項，其進一步包括「一框架；至少二固定螺栓；及至少二螺帽；其中，該框架蓋覆於探針卡母板第一面之一相反面，該固定螺栓可在穿透該金屬壓板、緩衝墊板、探針卡母板及框架後，該螺帽可鎖固於固定螺栓之一端」證據7之「調整板」、「螺栓」、「螺帽」已對應揭示系爭專利請求項7「框架」、「固定螺栓」、「螺帽」之技術特徵，且證據7之調整板與系爭專利請求項之框架均為加強（提升）探針卡整體之機械強度，系爭專利自承先前技術、證據2、5、6、7均為探針卡之相同領域，且證據5與7均為解決探針板不同板材間結合鎖固之問題，故兩者所欲解決問題具共通性，故上開證據間具組合的動機，所屬技術領域中具通常知識者在依據系爭專利自承先前技術及證據2及5之結構，為增加探針卡整體之機械強度，有合理的動機會採用證據7之教示加一框架結構而完成系爭專利

請求項7之創作，故系爭專利自承之先前技術及證據2、5、7之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性，系爭專利自承之先前技術及證據2、5、6、7之組合亦足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

綜上，上訴人智慧局未及審酌新證據所為「請求項1至7舉發不成立」之審定，即有未洽，訴願決定予以維持亦有未當，爰撤銷原處分及訴願決定，並命上訴人智慧局就系爭專利應為「請求項1至7舉發成立，應予撤銷」之處分。

五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴理由再予補充論述如下：

按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定。」為專利法第119條第3項本文所明定，查系爭專利申請日為101年11月23日，經上訴人智慧局於102年4月8日形式審查核准專利，並於102年7月11日公告。嗣被上訴人於106年5月2日提出舉發，經上訴人智慧局審查，於106年10月17日作成原處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准處分時所適用之100年12月21日修正、102年1月1日公布施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。次按，利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，且可供產業上利用者，得依核准時專利法第104條、第120條準用第22條第1項規定，申請取得新型專利。新型如係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第120條準用第22條第2項亦定有明文。

經查，原判決係以：由於金屬彈性變形的原理是原子晶格、鍵長及鍵角的微小改變造成，因此金屬的應變量極低，一般為0.1%，與一般所稱的彈性材料通過分子鏈的伸展可拉伸至5~10倍，其作用原理或是應變量的數量級係屬不同，且所屬技術領域中具通常知識者一般不會將單純的金屬材料視為一彈性體，故系爭專利之導電彈性凸塊並不等同於金屬凸塊。然因系爭專利自承之先前技術即圖11已揭露一種探針卡結構，其與系爭專利請求項1之差異在於系爭專利之金屬墊上

皆具有一導電彈性凸塊，且轉接介面板第一面覆蓋有一層防焊漆，且該導電彈性凸塊仍突出於該層防焊漆，當探針卡母板與轉接介面板相互結合時，每一個探針卡母板金屬墊與該每一個導電彈性凸塊進行電性連接。而證據5圖7則揭示於IC測試載板及IC測試母板上均覆蓋有一防焊綠漆，且金屬凸塊突出於防焊綠漆，是證據5已揭示藉由金屬凸塊突出於防焊漆，以傳遞IC測試母板及IC測試載板之測試訊號，及利用防焊漆避免破壞金屬墊之技術內容。又系爭專利自承之先前技術中，圖10係使用彈簧針作為連接器，因彈簧針之材質具有彈性且可導電，而具有緩衝及信號連接之效果，而圖11之垂直導電膠含橡膠及導電金屬，其包含之橡膠亦屬彈性材質，故所屬技術領域中具通常知識者可依據系爭專利之先前技術結合證據5之金屬凸塊及防焊漆，並將該金屬凸塊採用彈性材質以達成緩衝效果，進而完成系爭專利請求項1之創作，則系爭專利之先前技術及證據5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，是原審係依據卷內證據本於經驗法則及論理法則而為上述判斷，並非採用當事人所不知，惟為法院所已知之特殊專業知識作為裁判基礎，即不致於對當事人造成突襲性裁判，自無違反智慧財產案件審理法第34條準用第8條之規定。況原審於準備程序中，即諭知爭點（其中第爭點為證據5及系爭專利自承之先前技術之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性），並曉諭當事人就「系爭專利導電彈性凸塊，是否被證據5、6之凸塊所揭露」之事實進行辯論，而當事人於準備程序及言詞辯論程序均已就上開爭點進行陳述，而已使當事人為事實及法律上完全之辯論。上訴意旨以：原審未就「將該金屬凸塊採用彈性材質以達成緩衝效果」之重要見解，使當事人進行辯論，有違行政訴訟法第125條、第141條、第189條、第176條準用民事訴訟法第278條之規定，亦違反智慧財產案件審理法第34條準用第8條之規定云云，即非可採。

次查，原判決係認為依系爭專利說明書及圖式內容可知，系

爭專利之導電彈性凸塊係位於金屬墊上，且外觀呈現突起，並具彈性的導電結構，故導電彈性凸塊於文義上並不包含系爭專利自承之先前技術所揭示彈簧針之彈簧形狀結構及垂直導電膠之平面結構。另因金屬與彈性材料不同，故所屬技術領域中具通常知識者並不會將單純金屬材料視為彈性體，故證據5之金屬凸塊雖係外觀呈現突起之導電結構，但不具彈性，即與系爭專利之導電彈性凸塊有所不同。然因證據5之金屬凸塊僅須置換金屬為彈性材料之導電體，即可該當於系爭專利之導電彈性凸塊，則原判決據此認定所屬技術領域中具通常知識者可依據系爭專利自承之先前技術（例如主要含括橡膠及導電金屬之垂直導電膠，其中橡膠即為彈性材質）結合證據5之金屬凸塊，可將金屬凸塊採用彈性材質以達成緩衝效果（詳如前述），而認具有材料之置換容易性，即與前揭理由係敘述結構之差異，二者迥然不同，是原判決所載理由前後並無牴觸，亦無理由不備之違法。上訴意旨以：原審判決一方面認定系爭專利的「導電彈性凸塊」與先前技術之「彈簧針」以及「垂直導電膠」均不相同，與證據5的「金屬凸塊」亦不等同，另一方面卻認為結合該「金屬凸塊」與「彈簧針」或「垂直導電膠」，即可輕易完成系爭專利的「導電彈性凸塊」，亦未說明何謂將該金屬凸塊改變為具彈性之導電凸塊，其理由顯有前後牴觸及理由不備之違法云云，亦不足採。

ŋ 至上訴意旨以：證據2之治具框座係疊合在墊板的上方，而非圍繞墊板，積體電路測試載板係置入治具框座中央開口，而被治具框座所圍繞，積體電路測試載板與治具框座共同位在上層，積體電路測試載板根本不可能被放入墊板的開口中，兩者明顯位於不同層間，原判決徒憑臆測且作出反於客觀真實的認定，其判決顯有不當云云。查系爭專利請求項4之內容為：「如申請專利範圍第1項或第2項所述之探針卡免焊接結構，其中，更包括：至少一緩衝墊板；至少一治具座；及至少一金屬壓板，係位於與該轉接介面板第一面相對之一

轉接介面板第二面；其中，當該探針卡母板與該轉接介面板相互結合時，該緩衝墊板係位於轉接介面板之周圍，該治具座係位於緩衝墊板之周圍，該金屬壓板則以一個垂直於該轉接介面板第二面且平行於緩衝墊板之周圍與治具座之周圍的方向，壓制於緩衝墊板、治具座與轉接介面板第二面上。」是其係界定探針卡母板與該轉接介面板相互結合時，該緩衝墊板係位於轉接介面板之周圍，該治具座係位於緩衝墊板之周圍。而證據2說明書則記載「請參閱圖1所示，為本創作積體電路測試載板免焊接組裝改良結構立體分解圖，包括：……；一治具框座4，其裝置於PCB母板6上，該積體電路測試載板2和一或一個以上壓制板1裝置於該治具框座4內；一或一個以上墊板5，其裝置於PCB母板6與治具框座4之間，……」是依證據2圖1僅揭示治具框座（相當於系爭專利之治具座）係位於積體電路測試載板（相當於系爭專利之轉接介面板）之周圍，治具框座則係與墊板（相當於系爭專利之緩衝墊板）相互重疊，墊板係位於積體電路測試載板之下面，而與系爭專利請求項4之緩衝墊板及轉接介面板暨治具座及緩衝墊板之相對位置關係有所不同，是原判決認定證據2已揭示系爭專利請求項4之所有附屬技術特徵，固非妥適。惟依系爭專利說明書記載「參閱圖4，係本創作之探針卡免焊接結構之第三較佳實施例透過壓制的方式之實際應用示意圖。除了圖3所具備的元件與結構外，探針卡免焊接結構3更配合其它元件而成為一完整之透過壓制的方式之實際應用結構，該實際應用結構更包括：一機框320、至少二固定螺栓329、至少二螺帽329 、至少一緩衝墊板324、一治具座325、及至少一金屬壓板326，係位於與該轉接介面板第一面321相對之一轉接介面板第二面327；……，如此，可強化各元件間的緊固力，以令探針卡免焊接結構更堅固，……」是系爭專利請求項4之緩衝墊板、治具座及金屬壓板等構造之組合，其目的係為強化壓制結構，使之更為堅固，而證據2說明書亦載明「壓制治具的選材、設計及機械加工，為確保壓制能力

可抵抗具彈性的垂直導電材料其反作用力，故治具的選材更需謹慎，而且必須兼顧可行性及成本的考量。」、「本創作所提供之免焊接的積體電路測試載板組裝結構，與其他習用技術相互比較時，更具有下列之優點：……3.可透過治具的壓制及下壓行程的控制，可將平坦度不佳的積體電路測試載板（IC Substrate）固定於同一平面，藉由下壓行程的控制達到水平調整的功能，改善平坦度的問題。」是證據2之治具框座與墊板之構造組合，其目的亦係用以固定整體壓制結構，且證據2係採用具有彈性之垂直導電材料用以傳遞積體電路測試載板及PCB母板間之信號，系爭專利則係採用導電彈性凸塊使探針卡母板及轉接介面板進行電性連接，二者之壓制結構均須解決抵抗彈性材料反作用力之問題，則所屬技術領域中具有通常知識者，為解決結構不堅固之問題，即有動機參考同為探針卡結構之證據2之技術內容，而完成系爭專利請求項4之創作。證據5及系爭專利所自承之先前技術之組合既已足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，則證據2、5及系爭專利所自承之先前技術之組合亦足以證明系爭專利請求項4不具進步性，是原判決之結論即無違誤。

ē綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條，民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

中　華　民　國　108　年　12　月　12　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　吳　明　鴻

法官　蕭　惠　芳

法官　曹　瑞　烽

法官　高　愈　杰

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　108　年　　12　　月　　12　　日

書記官　劉　柏　君